GAP-145F-SOLO - Serie G6
SERVER RUGGED 1U

Intel® Xeon® Scalable - Singolo socket

I/O Motherboard Frontali e Alimentatore Posteriore

1U	450 mm	1	1,5TB	3+3	2
Piattaforma	Profondità	CPU	RAM	SSD	Schede I/O

GAP è una linea di server e workstation rugged realizzati in alluminio, progettati per applicazioni che richiedono un apparato robusto e qualificato, adatto a operare in ambienti critici.

I server rugged GAP-145F-SOLO Serie G6 integrano singolo processore Intel® Xeon® Scalable Processors (Skylake-SP / Cascade Lake-SP) che offre fino a 28 core e 56 thread, fino a sei canali di memoria, supporto AVX-512 e fino a 48 linee PCIe 3.0. I servizi di IPMI supportati consentono il controllo locale e remoto dei dispositivi integrati e permettono la segnalazione di allarmi e l'intervento immediato in caso di criticità.

GAP-145F-SOLO è progettato per montaggio a rack 19", è caratterizzato da 1U di altezza e 450mm di profondità. La configurazione con I/O motherboard frontale e alimentatore posteriore offre tutte le interfacce sul lato anteriore dello chassis mantenendo l'ingresso di alimentazione sul retro.
I server rugged serie GAP-145F-SOLO possono ospitare tre SSD estraibili, tre SSD interno e un DVD Slim e possono integrare fino a due schede PCI full size.
Le schede aggiuntive possono essere provviste di sistemi di fissaggio dedicati per garantire il funzionamento ottimale anche in presenza di shock e vibrazioni o durante il trasporto.

I server rugged GAP sono conformi alle MIL-STD-810F per temperatura e shock, alle MIL-STD-167-1A per vibrazioni e opzionalmente alle normative MIL-STD-461. Su richiesta gli I/O e l'ingresso di alimentazione possono essere dotati di connettori MIL-GRADE.

Tutte le configurazioni sono accompagnate da inventory list per garantire il controllo della configurazione e la riproducibilità nel tempo. Su richiesta gli apparati integrati possono essere sottoposti a specifici profili di stress termico o meccanico.

CARATTERISTICHE

- Server Rugged 1U - 450mm profondità
- Singolo processore
- Intel® Xeon® Scalable
- I/O motherboard frontali
- Ingresso di alimentazione posteriore
- Alimentatore Ridondato AC o DC
- Fino a 3 SSD Hot Swap + 3 SSD interni
- Fino a 2 schede PCIe
- Conformal Coating opzionale
- MIL-STD-810G
- MIL-STD-461 opzionale

Specifiche Tecniche

Sistema

Processore	Famiglia Intel® Xeon® Scalable - singolo socket P (LGA 3647)
Memoria	Fino a 1,5TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933/2666MHz 6 slot DIMM
Chipset	Intel® C622
Porte rete	2 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x RJ45 dedicata IPMI
Storage	2.5" SATA Disk - RAID 0, 1, 5, 10
TPM	1 TPM Header
I/O motherboard	Disponibili sul fronte: 1 x VGA, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI, 1 x COM
Schede aggiuntive	Fino a 2 schede PCIe Full Size 2x PCI-Express 3.0 x16 2 SuperDOM (Disk on Module) ports with built-in power 1x M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4 and SATA - Form Factor: 2280, 22110 Key: M-Key Double Height Connector
Sistemi operativi	Windows® 8.1 Enterprise, Windows® 10 IoT Enterprise 2016, Windows® Server 2012 R2; Windows® Server 2016; Windows® Server 2019; Linux®, VmWare®
IPMI	IPMI2.0, SPM, Watchdog; notifica degli allarmi via SNMP ed e-mail
Monitoraggio remoto	Controllo delle funzionalità di sistema (velocità ventole, temperature, tensioni, alimentazione, consumi, stato dei dischi, stato delle memorie e della configurazione RAID)

Alimentazione

Alimentatore	100/240 VAC Ridondato 18-36 VDC Singolo o Ridondato 36-72 VDC Singolo o Ridondato

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni	483 x 44,45 x 450 mm
Materiale	Alluminio con trattamento di passivazione superficiale
Colore	Silver
Alloggiamento	Chassis 1U per montaggio a rack 19" Guide telescopiche opzionali
Configurazione	I/O motherboard frontali e alimentatore posteriore
Pannello frontale	Led: Led Power ON e funzionalità HDD/SSD; Pulsanti: Power ON / OFF e System Reset
Baie Drive	1 x DVD slim; 1 x baia 3.5" + 3 x alloggiamento per ODD 2.5" interno

Parametri Ambientali - (Design to meet)

Temperatura operativa	Standard: 0°C / +50°C Estesa: -20°C / +60°C (in funzione delle configurazioni)
Umidità operativa	Da 8% a 95% non-condensata (in funzione delle configurazioni)
Temperatura storage	-40°C / +70°C
Vibrazioni	MIL-STD-810G, Method 514.7, Cat 4 - Proc. I - 2.24 Grms, 5-500 Hz 60 min/axis for 3 axes
Shock operativo	MIL-STD-810G Proc. I Method 516.7 - 15g / 11ms – half sine
Shock trasporto	MIL-STD-810G Proc. II Method 516.7 - 30g / 9ms sawtooth
Certificazioni	Direttiva 2014/35/UE-LVD / Direttiva 2014/30/UE-EMC Direttiva 2011/65/UE - RoHS / Regolamento (EC) No 1907/2006 - REACH

I server e le workstation GAP sono progettati in conformità alle specifiche ambientali indicate. Alcuni parametri dipendono dalla configurazione. Gli apparati possono essere sottoposti a profili di prova dedicati.